

<<电子组装技术>>

图书基本信息

书名：<<电子组装技术>>

13位ISBN编号：9787118066913

10位ISBN编号：7118066915

出版时间：2010-3

出版时间：国防工业出版社

作者：宋长发

页数：281

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<电子组装技术>>

### 内容概要

本书系统介绍了电子组装的基本材料元器件、印制电路板的制造工艺过程，焊接材料的种类、特性及工艺特点，电子组装生产线的组成，各种组装设备的基本结构和使用方法，电子组装各工艺环节的工艺方法和工艺参数的设置及优化，电子组装过程中的检测技术与检测设备的工作原理，生产过程中的静电防护技术及技术质量管理等内容。

本教材配有课件，方便教师使用多媒体教学。

本书既适用于应用型、技能型人才培养的普通高校应用电子类专业的本科教学，也适用于高职高专、成人教育相关专业的教学，同时可作为电子组装专业技术培训和从事电子组装的工程技术人员参考书。

## <<电子组装技术>>

### 书籍目录

第1章 电子组装技术概述第2章 表面组装元器件第3章 表面组装印制电路板第4章 钎焊机理第5章 焊料合金第6章 电子组装辅助材料第7章 焊膏与黏接剂涂敷技术第8章 贴装设备与贴装技术第9章 焊接设备与焊接技术第10章 清洗技术与清洗设备第11章 SMT检测技术与检测设备第12章 电子产品生产中的静电防护技术第13章 电子组装生产质量管理附录 行业标准参考文献

## &lt;&lt;电子组装技术&gt;&gt;

## 编辑推荐

本书共13章，内容包括电子组装的历史发展过程和电子组装工艺技术的现状及其发展趋势，详细介绍了三种电子组装基本材料：元器件的内部结构、外形尺寸、引脚形状、制造工艺和包装形式；组装用印制电路板的种类、结构形式、材料特点、制造工艺方法；焊接材料中的焊锡膏的种类、特性及制作方法、无铅焊料的性能和工艺特点。

此外还简单介绍了电子组装三种辅助材料：贴装胶的种类、性能及使用方法；助焊剂的种类、性能及使用方法；清洗剂的种类、性能及使用方法。

还介绍了焊锡膏和贴装胶的涂敷工艺方法及其设备的结构和使用方法，重点介绍了贴片机的种类、基本结构、性能特点、使用方法。

介绍了手工方式、半自动方式和全自动方式三种贴装工艺，详细介绍了全自动贴装方式工艺参数的设置和优化方法。

介绍了焊接方法的基本类型和基本原理，焊接工艺参数的设置及优化，焊接温度曲线的设计和 optimization 方法。

介绍了各种焊接设备的基本结构、工作原理和使用方法。

此外还介绍了印制电路板上污染物的种类及清洗原理，各种清洗工艺方法。

介绍了清洗设备的种类和基本结构、使用方法。

最后介绍了电子组装过程中的检测技术与检测设备的工作原理、返修技术、静电防护技术及技术质量管理等内容。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>